



- 新闻动态 >
- 通知公告 (/../xwdt.htm) >
- 学术信息 (/../tzgg.htm) >
- (/../index/xsxx.htm)

## 新闻动态

当前位置: 网站首页 (/../index.htm) > 新闻动态 (/../index/xwdt.htm) > Content

### 《镁合金学报》成功入选中国领军期刊

作者: 材料科学与工程学院 杨艳, 期刊社 王维明 日期: 2019-11-25

为深入贯彻落实中央深改委第五次会议通过的《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》的精神, 中国科协、财政部、教育部、科技部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院七部委联合启动了“中国科技期刊卓越行动计划”。经项目申报、资格审查、答辩评审、专家委员会复核和公示, 我校主办的英文期刊《Journal of Magnesium and Alloys》(《镁合金学报》)成功入选领军期刊, 成为全国22种领军期刊之一。

“中国科技期刊卓越行动计划”是中央《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》明确的重点任务, 受到科技界和期刊界的密切关注。该行动计划按照领军期刊、重点期刊、梯队期刊、高起点新刊、集群化试点等五个方面来推进期刊发展, 同时在政策机制和人才培养方面予以推进。领军期刊作为我国最高水平的刊物必须充分体现刊物的高质量和中国在世界上的影响力。本次期刊卓越行动计划项目的遴选竞争十分激烈, 全国参与申报的248种英文刊中仅22种入选领军期刊类项目, 其中教育部主管、高校主办的期刊仅7种入选领军期刊。领军期刊项目为我国层次最高、资助力度最大的项目, 连续资助5年, 资助经费不低于100万元/年。

《镁合金学报》由重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心联合中国材料研究学会镁合金分会创刊于2013年(Elsevier出版社出版), 是在原中国工程院副院长师昌绪院士亲自指导下由重庆大学潘复生院士创办的全球第一本专注于镁及镁合金的学术期刊。该刊由重庆大学潘复生院士任主编, 彭晓东教授任常务副主编, 编委由来自美国、澳大利亚、加拿大、日本、俄罗斯等全球10余个国家镁合金领域知名专家构成, 包括国际镁协主席、韩国材料学会理事长、美国工程院院士、Acta Mater 和Mater Sci Eng国际刊物主编等一批国际著名科学家。期刊自创办以来, 得到了学校的高度重视和大力支持, 学术质量和学术影响明显提升, 目前已入选SCI、Scopus等国际重要数据库, 期刊2018年影响因子为4.523 (IF:4.523), 位居全球76种SCI收录的冶金与冶金工程类 (Metallurgy and Metallurgical Engineering) 学术期刊第5位, JCR分区1区。

培育世界一流科技期刊是学校贯彻落实中央文件精神 and 推动“双一流”建设的重要工作, 《镁合金学报》的入选是对我校期刊建设和发展的充分肯定, 标志着《镁合金学报》已具备重要的国际学术影响力, 有助于更好地服务于国家的科技创新体系建设。在申报过程中, 国家镁中心《镁合金学报》期刊编辑部和重庆大学期刊社高度重视、积极组织、精心准备, 申报工作还得到了重庆市委宣传部出版处的大力支持。

从学术期刊的角度来看, 世界一流科技期刊必须能够引领全球基础创新发展方向; 从技术期刊的角度来看, 世界一流科技期刊应该能够引领全球技术创新和产业发展方向。《镁合金学报》期刊编辑部今后将以此为契机, 依托专业学科力量, 建设成世界一流、国际化、高水平的领军科技期刊, 为学校“双一流”建设贡献力量, 助力我国加快世界一流科技期刊建设步伐, 夯实我国进军世界科技强国的科技与文化基础。

据悉, 本次“卓越行动计划”全国共有837种期刊 (中文刊495种, 英文刊342种) 和25个集群化试点单位参与申报, 最终遴选出领军期刊22种, 重点期刊29种, 梯队期刊199种, 高起点新刊30种, 集群化试点5项。重庆市共有4种期刊入选该计划, 其中重庆大学《镁合金学报》入选领军期刊, 陆军军医大学《中华创伤杂志 (英文版) 》和重庆医科大学《中华肝脏病杂志》入选梯队期刊, 重庆医科大学《基因与疾病》 (英文) 入选高起点新刊。

ISSN 2213-9567

# JMA

Journal of Magnesium and Alloys



National Engineering Research Center for Magnesium Alloys  
<http://www.ceremg.com.cn>

Volume 7, Issue 4  
2019 December

(C) Copyright Chongqing University All Rights Reserved.

重庆大学 版权所有2012 地址：重庆市沙坪坝区沙正街174号 邮编400044  
(渝ICP备05005762号) 技术支持：重庆巨软科技 (<http://www.massivesoft.cn/>)